



利機企業股份有限公司

股票代號：3444

2023

Investor Meeting

法人說明會

執行長 張宏基

2023.08.24

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw



投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



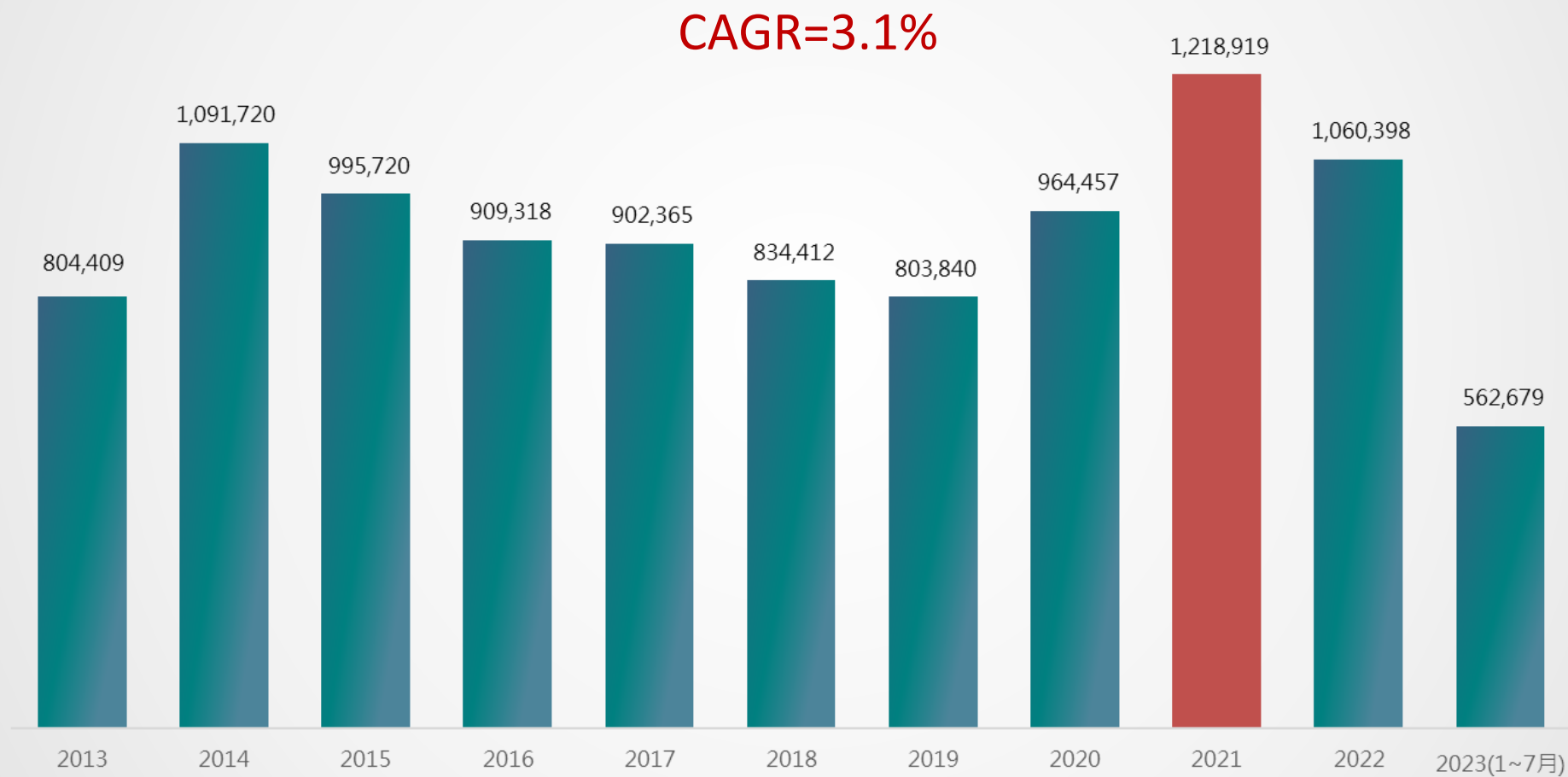
營運報告





歷年營收

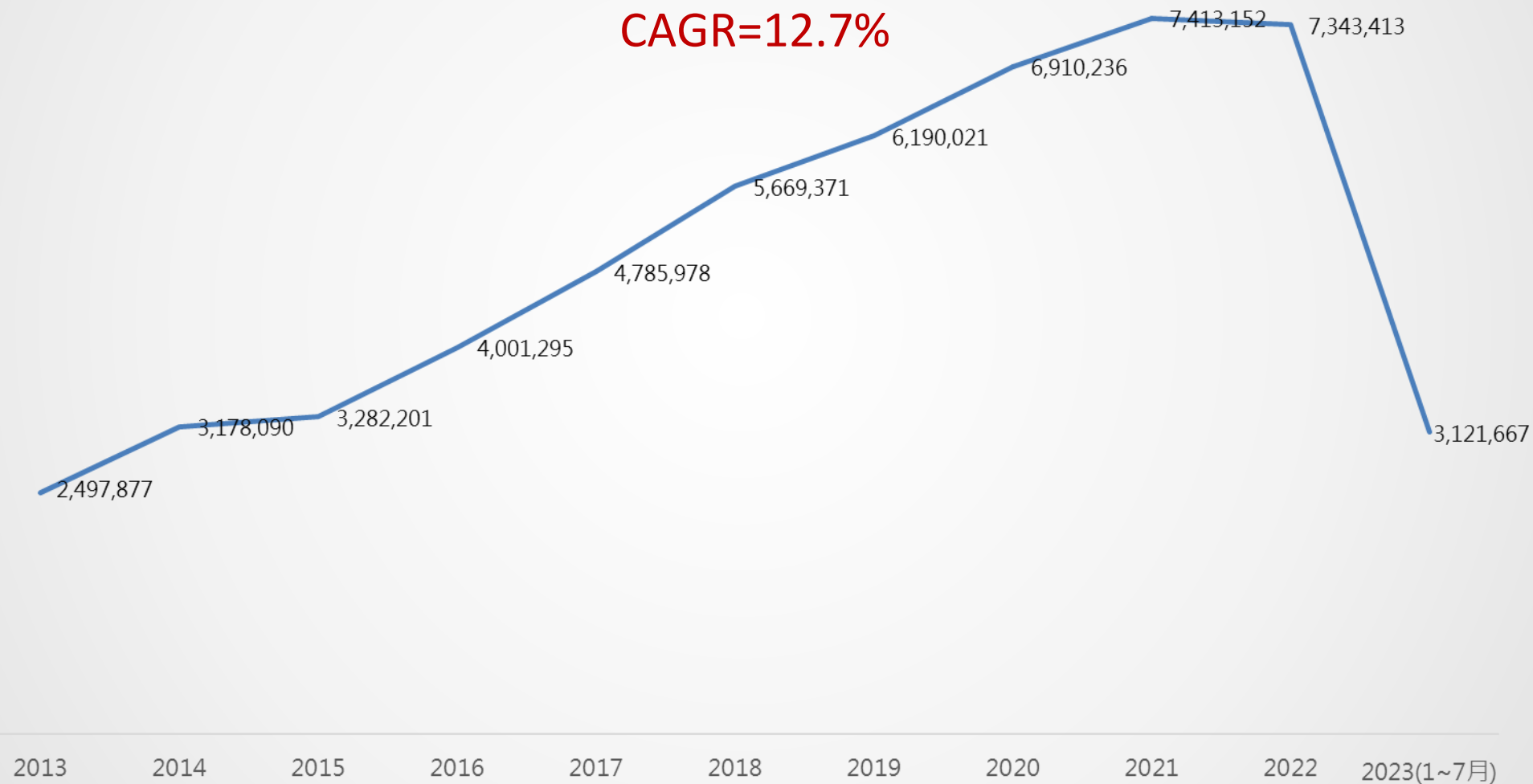
單位：仟元





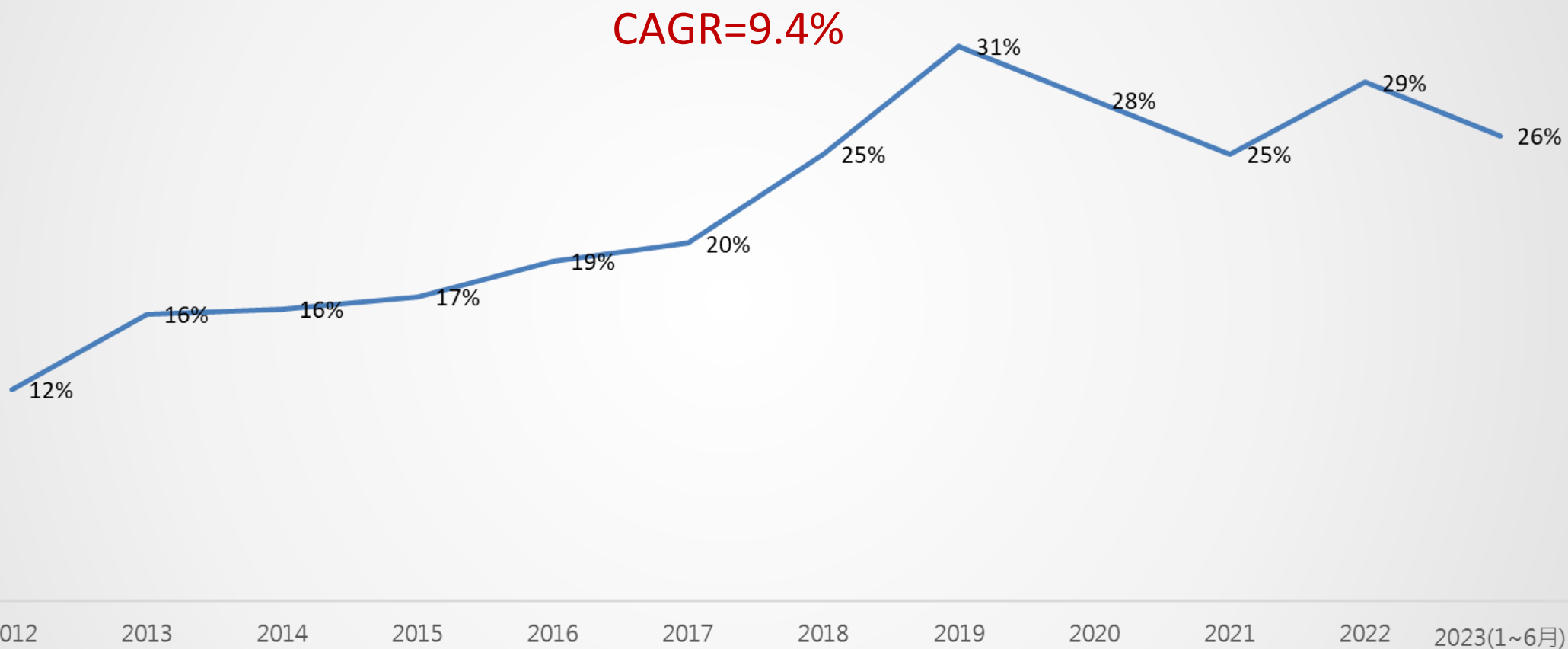
歷年整體交易金額

單位：仟元





歷年毛利率

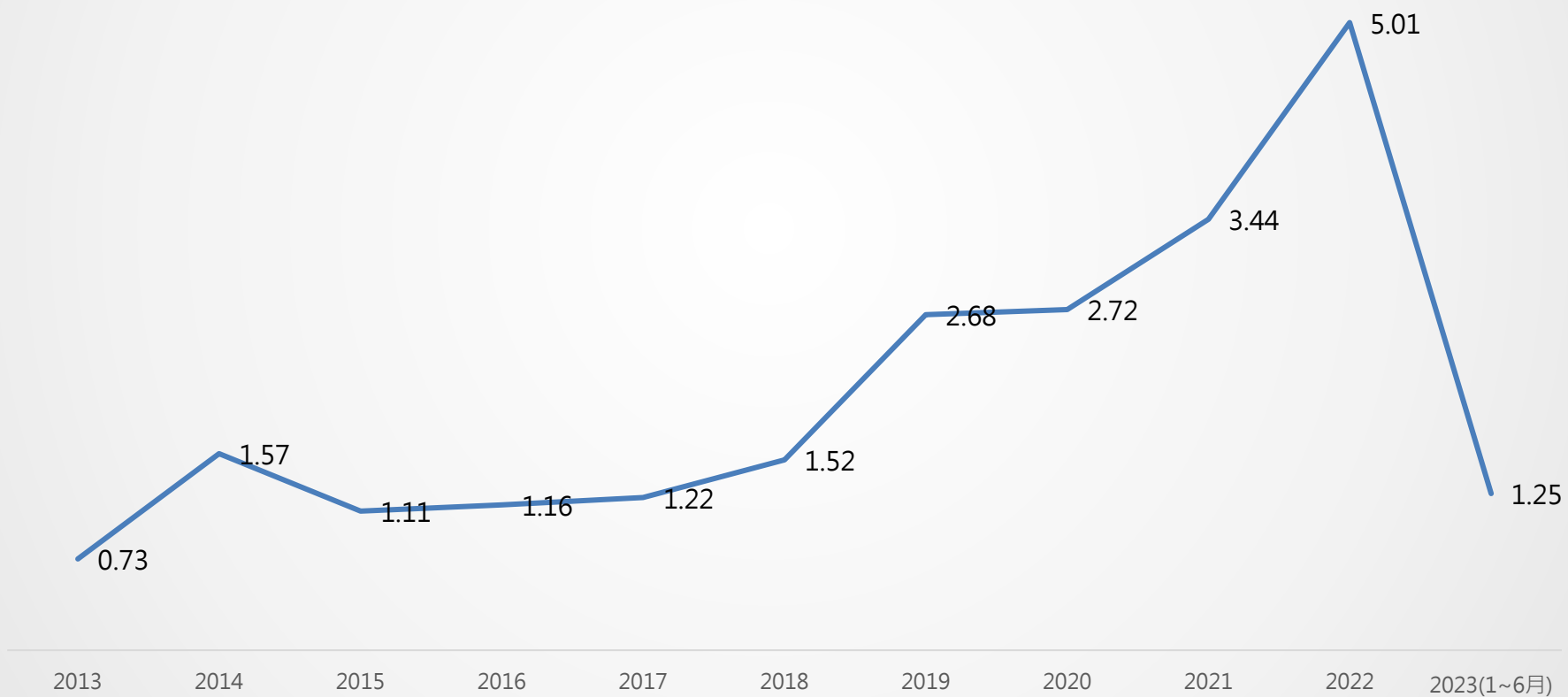




歷年每股稅後盈餘

單位：元

CAGR=23.9%

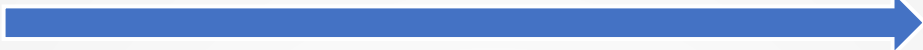


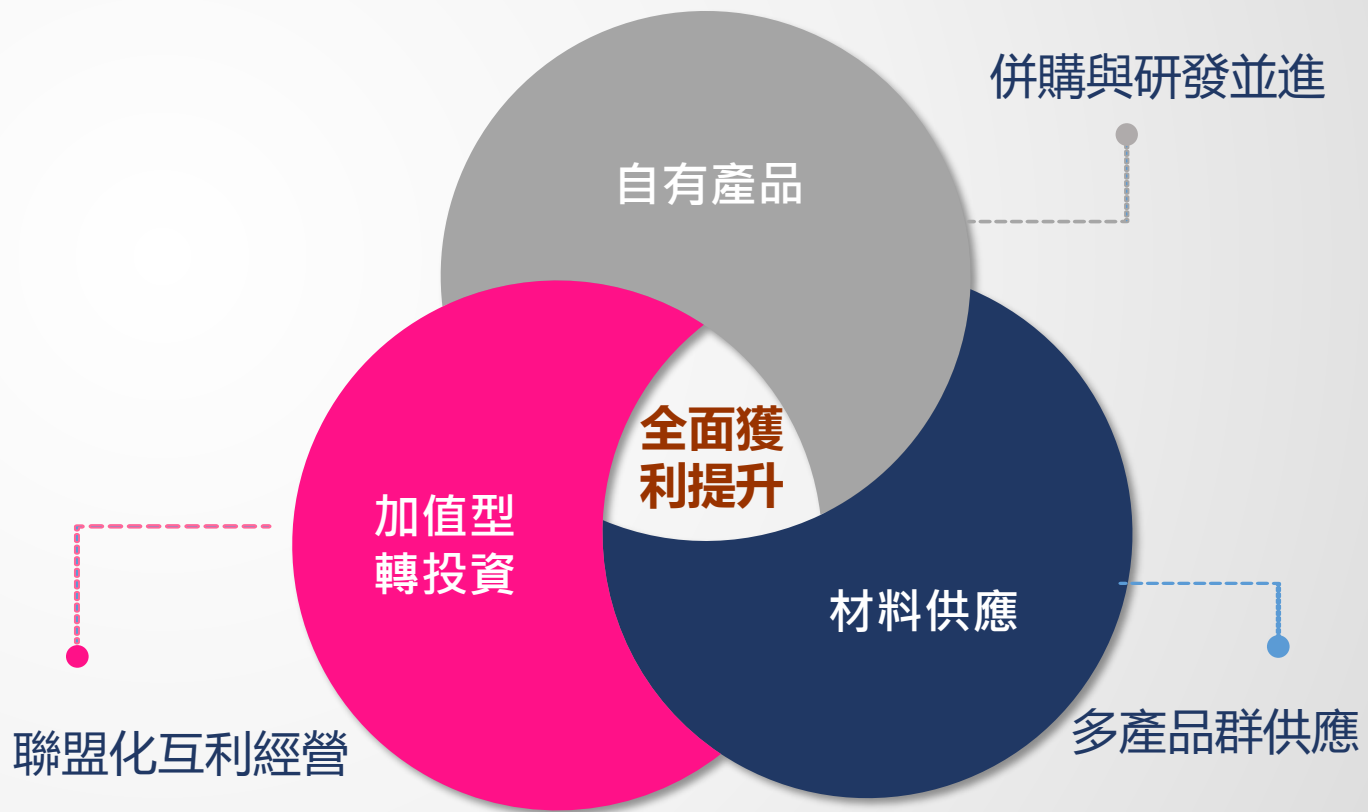
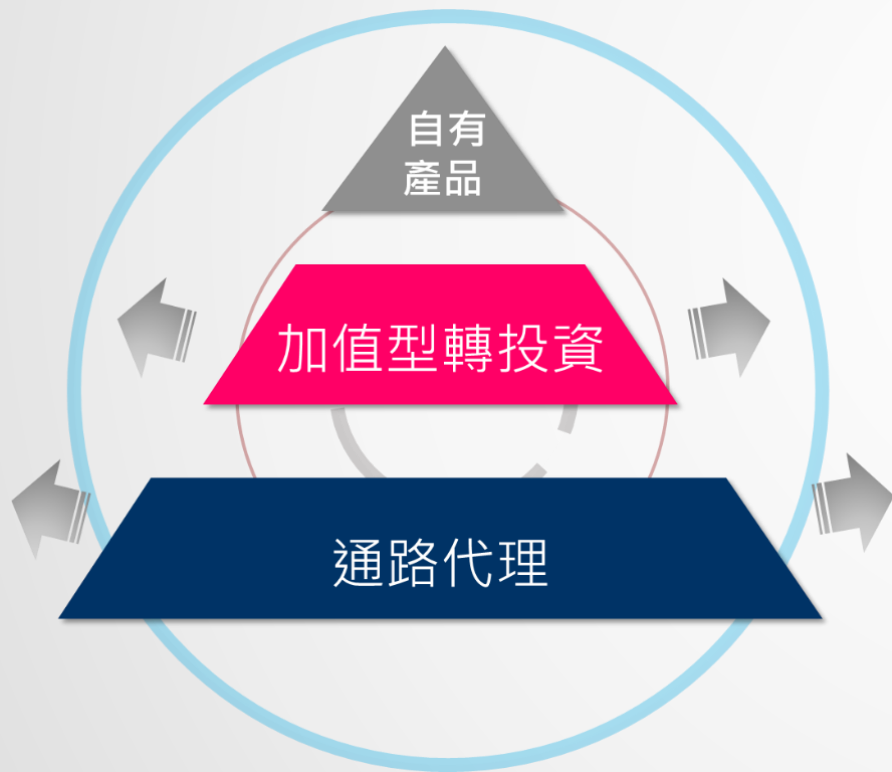


營 運 展 望

2023 Q3 & Q4

營運三佈局：全面獲利提升計畫

As is  To be

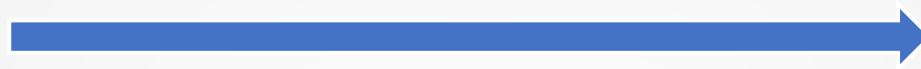




全面獲利提升計畫_自有產品

併購與研發並進的加速策略

As is



To be





全面獲利提升計畫_自有產品

自有研發產品核心技術 & 能力



產品優勢	特色
大尺寸晶片固晶	<ul style="list-style-type: none"> • 15 x 15 mm • 低模數
超低溫燒結	<ul style="list-style-type: none"> • 175oC燒結銀 • 低應力 • 具高信賴性
超高熱導性	<ul style="list-style-type: none"> • >230 W/mk • 高功率半導體及LED元件 • 應用於SiC, GaN
高接著強度及信賴性	<ul style="list-style-type: none"> • 可對應多種接著表面 • 通過TCT1000及MSL1



全面獲利提升計畫_自有產品

產品系列推展現狀

產品系列	EVT Engineering Verification Test (工程驗證測試階段)	DVT Design Verification Test (設計驗證測試階段)	PVT Production Verification Test (生產驗證測試階段)	MP Mass Production (導入量產階段)
客製化銀漿				DX 30 (L, Local) 車用部件 DX-23 (S, Local) RFID
高導熱銀漿			DN-1715(E, Local) 車用MOSFET DN-1715(E, Local) 車用LED	DN-1705(E, Local) 車用LED
低溫燒結銀漿	DN-1206Q (U, US) PMIC	DN-1806(A, Local) 封裝與測試 DN-1206Q(J, China) 封裝與測試	DN-1802(A, Netherland) RF-IC DN-1301B(S, US) RF-IC	
觸控銀漿		PS-07B(S, Local) 車用部件 PL-10(A, Local) 工控面板 PL-10(W, China) 觸控面板		PL 09F(H, Local) 工控面板 PL-10(M, Local) 工控面板

1. 至少10家國內、外客戶正在EVT及DVT階段
2. PVT階段的客戶，包含1家國際知名小訊號元件IDM廠的在台In-house封測廠; 及1家全美前3大RF IC的IDM廠



全面獲利提升計畫_自有產品

自有產品發展藍圖

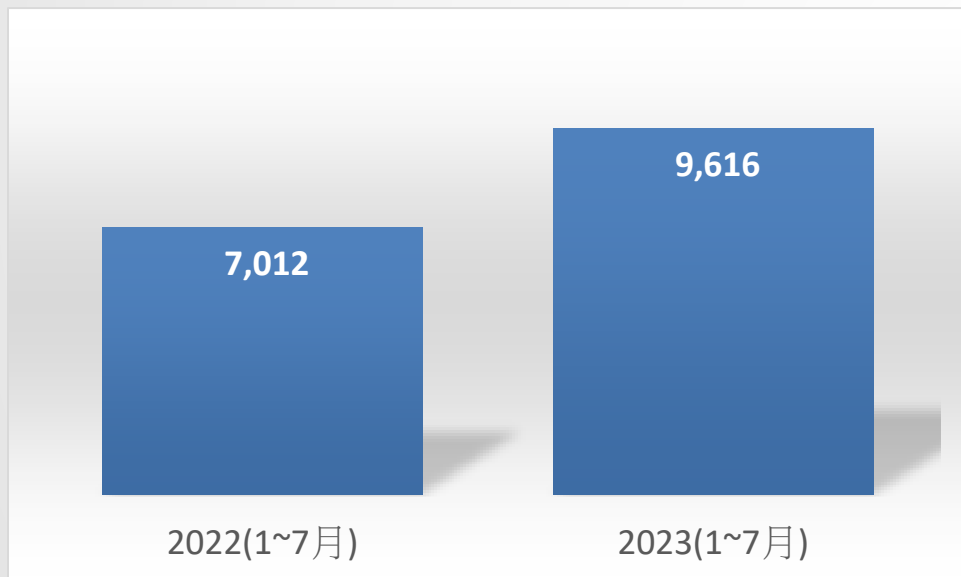




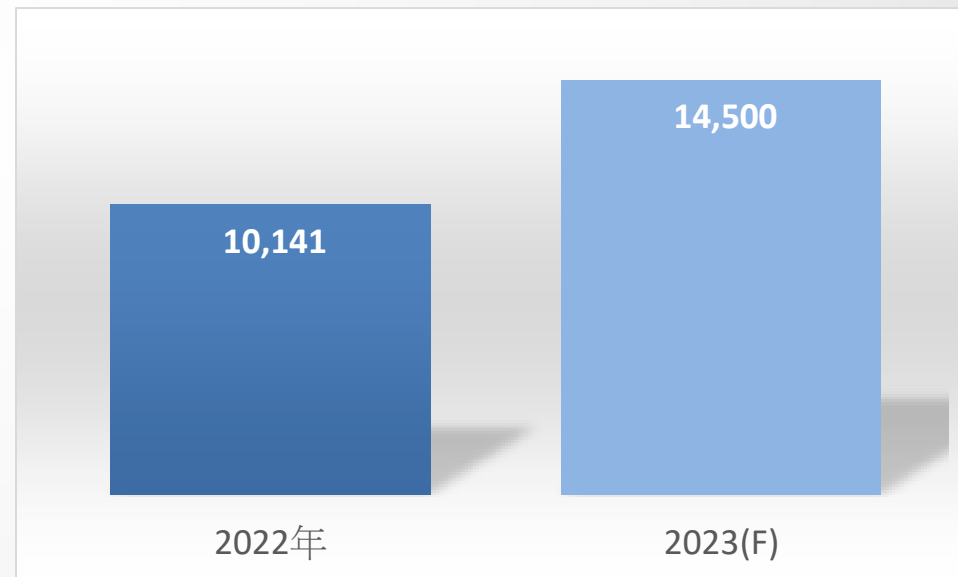
全面獲利提升計畫_自有產品

銀漿產品營收YOY

2023(1~7月) YOY= 37%



2023年 YOY= 43%





全面獲利提升計畫_自有產品

在手併購案加速規劃

更有效掌握交期、成本，提升競爭力

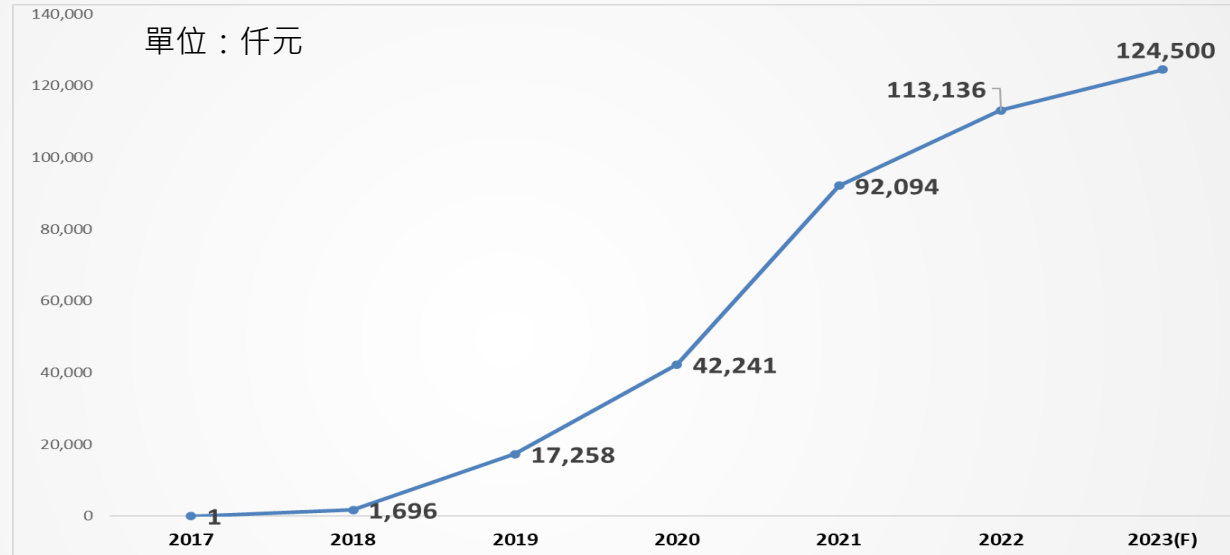




全面獲利提升計畫_自有產品

併購Heat Sink製造廠，全面提高自有產品比重

1. Heat Sink歷年營收



2. 以逐步增加股權方式完成收購; 此案現在進行中
3. **營收:** 預計2024年，Heat Sink+銀漿佔整體營收20%；並於3年內(2026E)及5年內(2028E)分別佔營收30%及40%
4. **毛利率:** 完成併購後，預期整體毛利率將增加5-10%
5. 成功自通路代理商轉型為高自製、高毛利的**全面性材料供應商**



全面獲利提升計畫_ 加值型轉投資

聯盟化互利經營的加深策略

As is



To be

精材科技

Utyc
精材實業

ENT利騰國際

enplas ENT

STNC 信泰蘇州

SIMMTECH®

1. STNC回歸由利機以利潤中心營運模式營運
2. 共同拓展System IC





全面獲利提升計畫_材料供應

多產品群供應的拓展策略

As is



To be



真空閥門

原廠：NOVASEN
原廠國別：Korea

原廠：VacuumALL
原廠國別：Korea

原廠：錦立
原廠國別：Taiwan

切割研磨 刀輪



原廠：賽爾科技
原廠國別：China



全面獲利提升計畫_材料供應

多樣產品群供應的拓展策略

- 一. 閥類已接獲訂單
- 二. 更進一步深化利機與Simmtech策略聯盟合作關係
- 三. 預估未來3~5年，材料供應接單金額會有數倍成長
- 四. 2024年毛利率回到30%以上，並有機會再創新高



本季總結

- 一. 啟動由通路商轉型為全面材料供應商的轉型計畫
- 二. 新材料產品已見訂單，預計2024Q2可貢獻營收
- 三. 燒結銀漿及高導熱銀膠獲國外大廠驗證測試通過，布局RF IC、高功率元件及小訊號元件市場，尤其是車用及工控市場，未來貢獻營收可期
- 四. 加值型轉投資STNC獲營運主導權，獲利貢獻有望大幅成長



THANKS